PAT-NO:

JР362035819A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62035819 A

TITLE:

WIRE CONNECTING DEVICE IN MOLD

PUBN-DATE:

February 16, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

AKIYAMA, TATSUHIKO

SHINOHARA, TOSHIAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

N/A

APPL-NO:

JP60176346

APPL-DATE:

August 9, 1985

INT-CL (IPC): B29C045/26, B29C033/02, H01L021/56, B29C039/10, G05D023/00

US-CL-CURRENT: 425/144

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable to stably supply current at elevated temperature and at the same time to stably compensate a temperature sensor for temperature by a method wherein the surface of each terminal is treated with gold plating and, when thermocouple is used for the temperature sensor, thermocouple temperature compensation wires are led just before the joining area of the terminal.

CONSTITUTION: All the surfaces of terminals 5∼ 8, which are respectively used for wiring cables connecting between a heater 2and a temperature controlling unit 4 and for thermocouple temperature compensation cables 12a and

12b connecting between a temperature sensor 3 and the temperature controlling unit 4, are treated with gold plating. A plurality of electrical connections are done by one action operation in such a manner that the terminal pairs 5 to 7 and 6 to 8 are automatically and simultaneously brought into contact at the on-position of a mold 1. Because almost all the courses from the temperature controlling unit 4 to the temperature sensor 3 are laid by thermocouple temperature compensation wire, the thermoelectromotive force generated by the thermocouple 4 can be correctly transmitted to the temperature controlling unit 4. Furthermore, because the terminal 5∼8 are treated with gold plating, no terminal oxidizes even when the temperature of the mold becomes high.

COPYRIGHT: (C)1987, JPO& Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

10特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-35819

<pre>⑤Int.Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		❷公開	昭和62年(1	987) 2月16日
B 29 C 45/26 33/02		8117-4F 8415-4F				
H 01 L 21/56 // B 29 C 39/10		T-6835-5F 7722-4F				
G 05 D 23/00 B 29 L 31:34		2117—5H 4F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全5頁)

劉発明の名称 金型結線装置

②特 願 昭60-176346

❷出 願 昭60(1985)8月9日

⑫発 明 者 秋 山 龍 彦 伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所

内

切発明者 篠原 利彰 伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所

内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 早瀬 憲一

明 細 書

1. 発明の名称

金型結線装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 半導体装置を樹脂封止する金型に内蔵されたヒータ及び温度センサーと、

該温度センサーによる検知温度に応じて上記と ータへの加熱電力量を制御する温度制御部との間 の結線を行なう金型結線装置において、

上記ヒータ及び温度センサーに接続された金メッキされた協子を有する金型側端子台と、

上記温度制御部に接続された金メッキされた協 子を有し各端子が上記金型側端子台の各端子と接 合される温度制御部側端子台とを憶えたことを特 徴とする金型結線装置。

(2) 上記温度センサーが熱電対からなり、上記金型側及び温度制御部側端子台の端子がすべて同一金属からなり、該温度センサーと上記金型倒端子台の端子の間及び上記温度制御部の温度センサーに対応する端子と上記温度制御部側端子台の端

子との間が熱電対温度補償線により配線されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 金型結線装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は半導体装置を樹脂封止する金型に内 酸されているヒータ及び温度センサーと、金型外 部の温度制御装置との電気的結合を行なう装置に 関するものである。

〔従来の技術〕

9 は嫡子 5 , 嫡子 6 を取付けた金型倒嫡子台、 1 0 は嫡子 7 . 嫡子 8 を取付けた温度制御部側嫡子 台、 1 1 は配級のためのケーブル、例えば銅線で あり、上記嫡子 5 . 6 . 7 . 8 はすべて同一金属、 例えば銅ータングステン合金で構成されている。

次に動作について説明する。半導体装置を樹脂 対止するための樹脂封止金型1に内蔵してのの を型1を加熱するためには、該金型1に内蔵しているとータ2及び温度センサー3と金型の温度を のための温度制御部4とを接続する必要がある。 その方法としてヒータ2の配線末端の端子6を取付けた 温度をセンサー3の配線末端の端子6を取付けた 温度制御部4側の配線末端の を取付けた温度制御部側端子台10とを 結合させ、 もさせ、 もしている。

(発明が解決しようとする問題点)

一般に樹脂封止金型は通常 180℃以上に加熱されるので、従来の装置の端子では容易にその接合面が酸化し、電気抵抗が増大して次第に電流が流

れにくくなる。また嫡子を同一金属で構成する場合、温度センサーとして、異種金属の熱起電力差を利用する熱電対を用いると、同一金属からなる 嫡子の両嫡の温度差分の熱起電力降下を生ずるという問題点があった。

この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、高温下においても温度制御部から金型内ヒータに常に安定した電流を供給でき、また温度センサーとして熱電対を用いた場合にもその温度センサーとしての機能を損なうことのないよう安定した温度補償を行なうことのできる端子を持つ、金型結線装置を得ることを目的とする。(問題点を解決するための手段)

この発明に係る金型結線装置は、嫡子表面に酸化に対する保護能力の高い金メッキ処理を施し、また温度センサーとして無電対を用いた場合にはその温度補償のため嫡子接合面の直前まで無電対温度補償線を配線したものである。

(作用)

この発明においては、端子の表面を金メッキ処

理することにより高温下での酸化による電流低下を防止することができる。また温度センサーとして熱電対を用いた場合に、金型内の温度センサーから金型外の温度制御部までを熱電対温度補償線を用いて配線することにより正確な熱起電力を温度制御部に伝達できる。

(実施例)

٠.٠

表面を金メッキ処理した嫡子、9は嫡子 7、嫡子 6を取付けた金型側嫡子台、10は嫡子 7、嫡子 8を取付けた温度御御部側のためのケーブルと温度制御部 4 との配線のためのをサー 3 とは銅線、12 a、12 bは温度対域のためのに対域のために対域のために対域のために対域のために対域のために対域のために対域のために対域のために対域のために対域のために対域のために対域のために対域のために対域のために対域のようには対域のように対域のように対域のように対域のように対域のように対域のように対域のように対域を受ける。 嫡子 6 と 8 が接合する固定台 1 3 上の位置に固たされる。

次に動作について説明する。樹脂封止金型1を加熱するため金型1に内蔵しているヒータ2の配線末端の端子5と、温度センサー3の配線末端の端子6を有し、金型1に固定された金型側端子台9と、温度制御部4の配線末端の端子7.8を有し、金型1の動作位置において自動的に端子5と

なお、上記実施例では樹脂封止金型と温度制御部との電気的結合を行なう金型結線装置に限定して説明したが、本発明は温度センサーを利用して温度制御し高温で動作する電気機器のための結線装置にも応用でき、上記実施例と同様の効果を期

待できる。

(発明の効果)

以上のようにこの発明によれば、端子に金メッキを施したので長期に渡って酸化による電流損失の少ない安定した温度制御が可能となる。また熱電対からなる温度センサー部と温度制御部との間を熱電対温度補償線により配線したので特度の高い温度制御が可能となる効果がある。

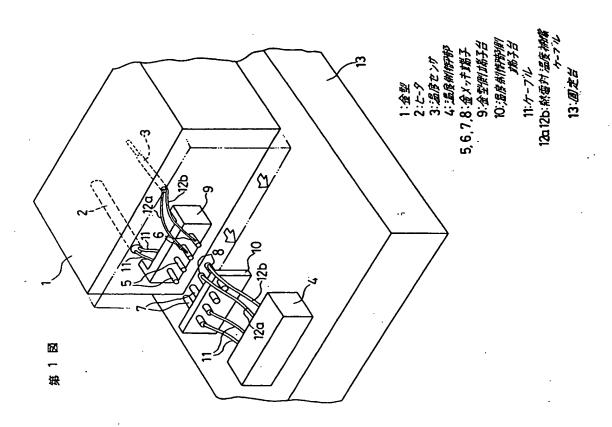
4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例による金型結線装置を示す斜視図、第2図は従来の金型結線装置を示す斜視図である。

1 … 金型、2 … ヒータ、3 … 温度センサー、4 … 温度制御部、5,6,7,8 … 金メッキ端子、9 … 金型倒端子台、10 … 温度制御部側端子台、12a,12b… 熱電対温度補償ケーブル。

なお図中同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 早湖 葱 一

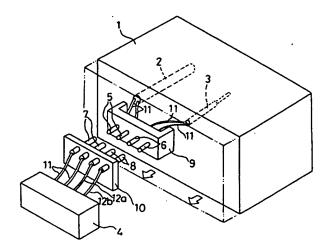


特開昭62-35819 (4)

手 続 補 正 偖(自発)

昭和 60年 12月20日

第2回.



特許庁長官殿

1. 事件の表示

特願昭 60-176346号

2. 発明の名称

金型結線装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601) 三菱電機株式会社

> 代表者 岐 / 守 哉

4.代 理 人 住 所

郵便番号 532

大阪市淀川区宮原 4 丁目 1 番45号

新大阪八千代ビル

氏 名 (8181) 弁理士 早瀬一葱

電話 06-391-4128



5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の標、及び図面(第 1 図、第2図)

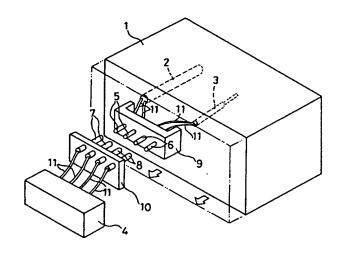
6. 補正の内容

(1) 明細書第3頁第3~4行の「例えば銅線で あり、上記竭子」を「例えば銅線であり、 1 2 a, 12 bは温度センサー3と温度制御部4との配線 のための熱電対温度補償ケーブルである。そして 例えば12aは銅、12bは銅ーコンスタンタン であり、上記婚子」に訂正する。

(2) 第1図及び第2図を別紙の通り訂正する。

以 上

第 2 図



特開昭62-35819(5)

